

深圳市晶盟电子科技有限公司

产品说明书

SPECIFICATIONS

型号: JM-G1309A1-BL

公司: 深圳市晶盟电子科技有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区西乡三围社区索佳科技园索佳综合楼A902

电话: 0755-23200023

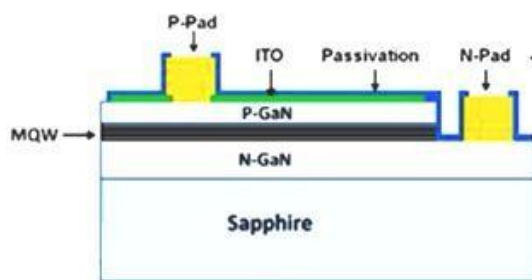
传真: 0755-29593377

网址: www.uniled.com.cn

一、产品特点

- ◆ 长寿命
- ◆ 高可靠性
- ◆ 高输出光
- ◆ 高抗静电能力
- ◆ 100%测试和分拣

二、LED芯片图示



三、产品尺寸

- ◆ 芯片尺寸/Chip size: $305 \pm 15 \mu\text{m} \times 229 \pm 15 \mu\text{m}$
- ◆ 芯片厚度/Chip thickness: $95 \pm 15 \mu\text{m}$
- ◆ P电极尺寸/P Electrode Size: $72 \pm 2.5 \mu\text{m}$
- ◆ N电极尺寸/N Electrode Size: $72 \pm 2.5 \mu\text{m}$

四、电极金属

- ◆ P电极/P electrode: 金 (Au)
- ◆ N电极/N electrode: 金 (AU)

五、光电参数

(Ta=22℃)

参数 Parameter	测试条件 Testing condition	符号 Symbol	最小值 Min.	最大值 Max.	单位 Unit
反向电流 Reverse Current	$V_r = -10V$	I_r	0	1	μA
正向电压 Forward Voltage	$I_f = 20mA$	S	2.8	2.9	V
		L	2.9	3.0	
		M	3.0	3.1	
		N	3.1	3.2	
		P	3.2	3.3	
波长 Wavelength (WLD)	$I_f = 20mA$	W3	449.5	451.0	nm
		W4	451.0	452.5	
		W5	452.5	454.0	
		W6	454.0	455.5	
		W7	455.5	457.0	
		W8	457.0	458.5	
		W9	458.5	460.0	
		WZ	460.0	461.5	
		BI	461.5	463.0	
		BJ	463.0	464.5	
		BK	464.5	466.0	
		BL	466.0	467.5	
		BM	467.5	469.0	
		BN	469.0	470.5	
		BO	470.5	472.0	
光功率 Light Output Power	$I_f = 20mA$	DA	14.0	15.5	mW
		DB	15.5	17.0	
		DC	17.0	18.5	
		DD	18.5	20.0	
		DE	20.0	21.5	
		DF	21.5	23.0	
		DG	23.0	24.5	
		DH	24.5	26.0	
		DJ	26.0	28.0	
		DK	28.0	30.0	
		DL	30.0	32.0	

※ 建议使用透明环氧胶或硅胶固晶以获得最佳光输出；

※ 氮化镓二极管是静电敏感器件，在接触过程中请做好静电防护。

※ 所有参数都是在工厂内测试机上测得的裸晶结果，mW值误差在±10%，WLD值误差在±1nm范围内。

六、特征曲线

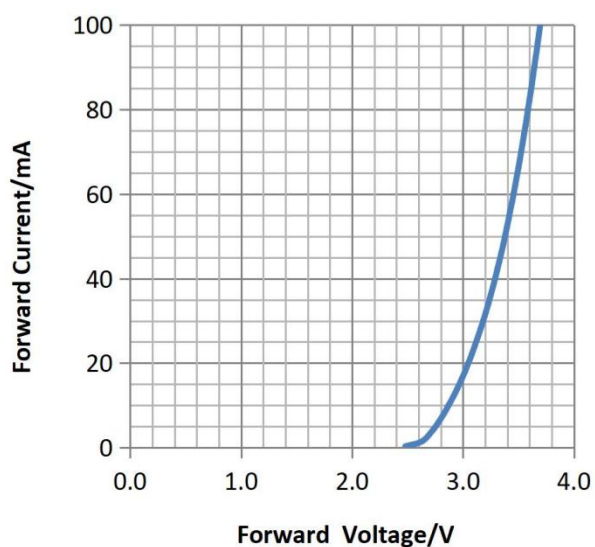


Fig.1-Forward Current vs. Forward Voltage

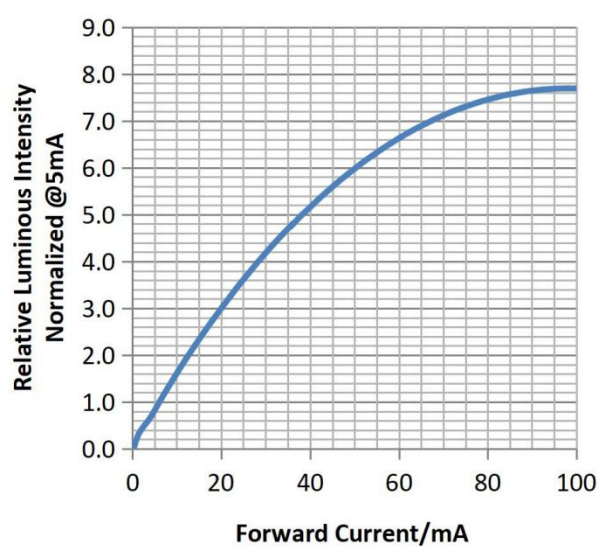


Fig.2-Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

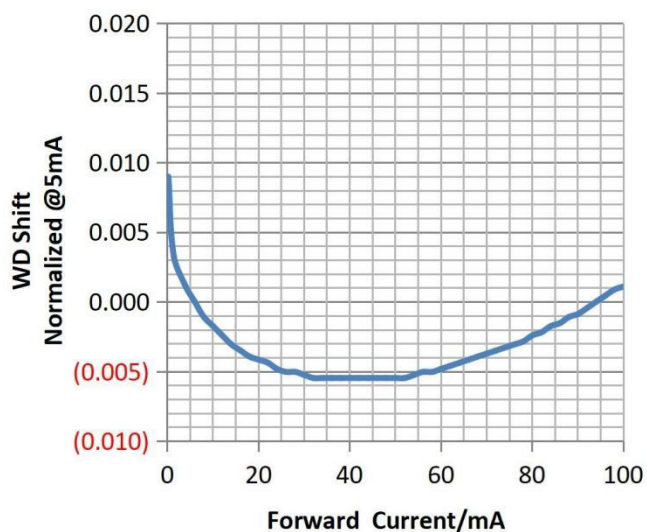


Fig.3-Forward Current vs. WD shift

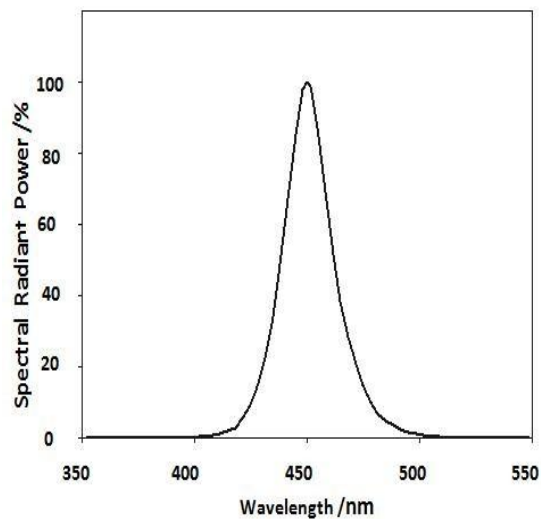


Fig.4- Wavelength vs. Spectral radiant power

注：以上曲线为依据工厂内封装测试数据绘制。

七、最大额定值

参数 Parameter	符号 Symbol	条件 Condition	额定值 Absolute Maximum Rating	单位 Unit
正向直流电流 Forward Current	I_f	$T_c=22^{\circ}\text{C}$	≤ 30	mA
结温 Junction Temperature	T_j	----	≤ 115	$^{\circ}\text{C}$
存储温度 Storage Temperature	T_{stg}	chip	$-40\sim+85$	$^{\circ}\text{C}$
		chip-on-tape/Storage	$0\sim 25$	$^{\circ}\text{C}$
		chip-on-tape/Transportation	$-20\sim+65$	$^{\circ}\text{C}$
封装温度 Storage Temperature	----	----	$260(<5s)$	$^{\circ}\text{C}$
静电测试ESD	----	通过率95%	3000	V

八、包装规格

◆ 芯片包装/Packaging: 中等粘度蓝膜/Blue tape medium tack